



Advance Materials Corporation

# 聯致科技股份有限公司

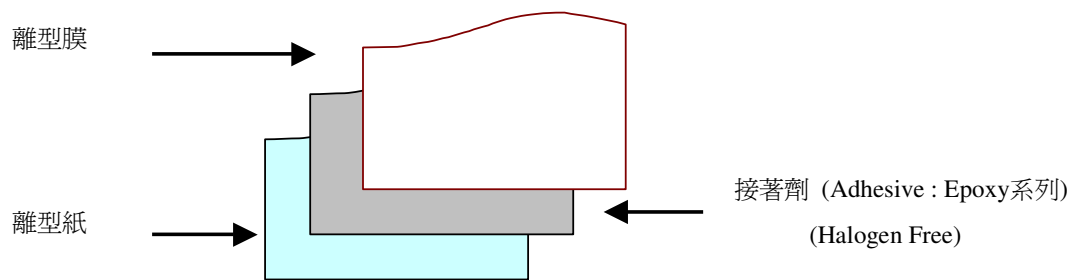
## 軟性印刷電路板材料

### 純膠產品技術資料

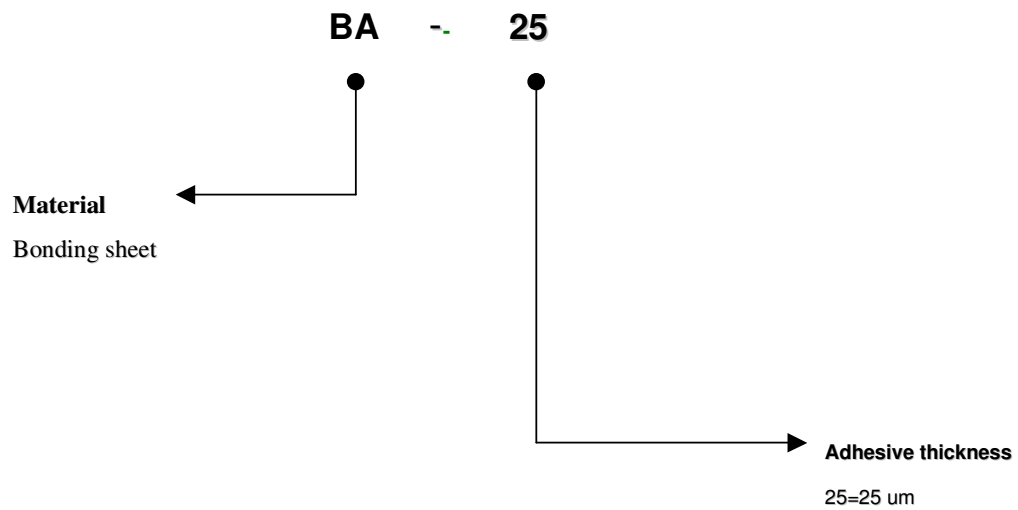
## 產品特性

1. 符合 UL-94-v-0 耐燃等級。
2. 低鹵素含量。
3. 低吸濕性。
4. 耐熱性佳及附著力佳
5. 溢膠量小。

## 產品組成



## 編碼原則



## 產品規格

產品型號	膠厚(μm)	總厚度(μm)
Name	Thickness of Adhesive (μm)	Total Thickness (μm)
BA-15	15	15
BA-25	25	25
BA-35	35	35
BA-50	50	50

## 保存方式

純膠的黏膠為熱固性的產品，在壓合時會產生流動性進行填滿線路，達到驅趕氣泡與提高抗撕強度的功用。此流動性會隨保存環境與保存時間而異，爲了在壓合時達到可靠的流動性與抗撕強度，建議保存在 5°C 的環境中，並於三個月內使用。

## 產品認證

1. UL : E201676
2. SGS

## FPC 快速壓合建議操作條件

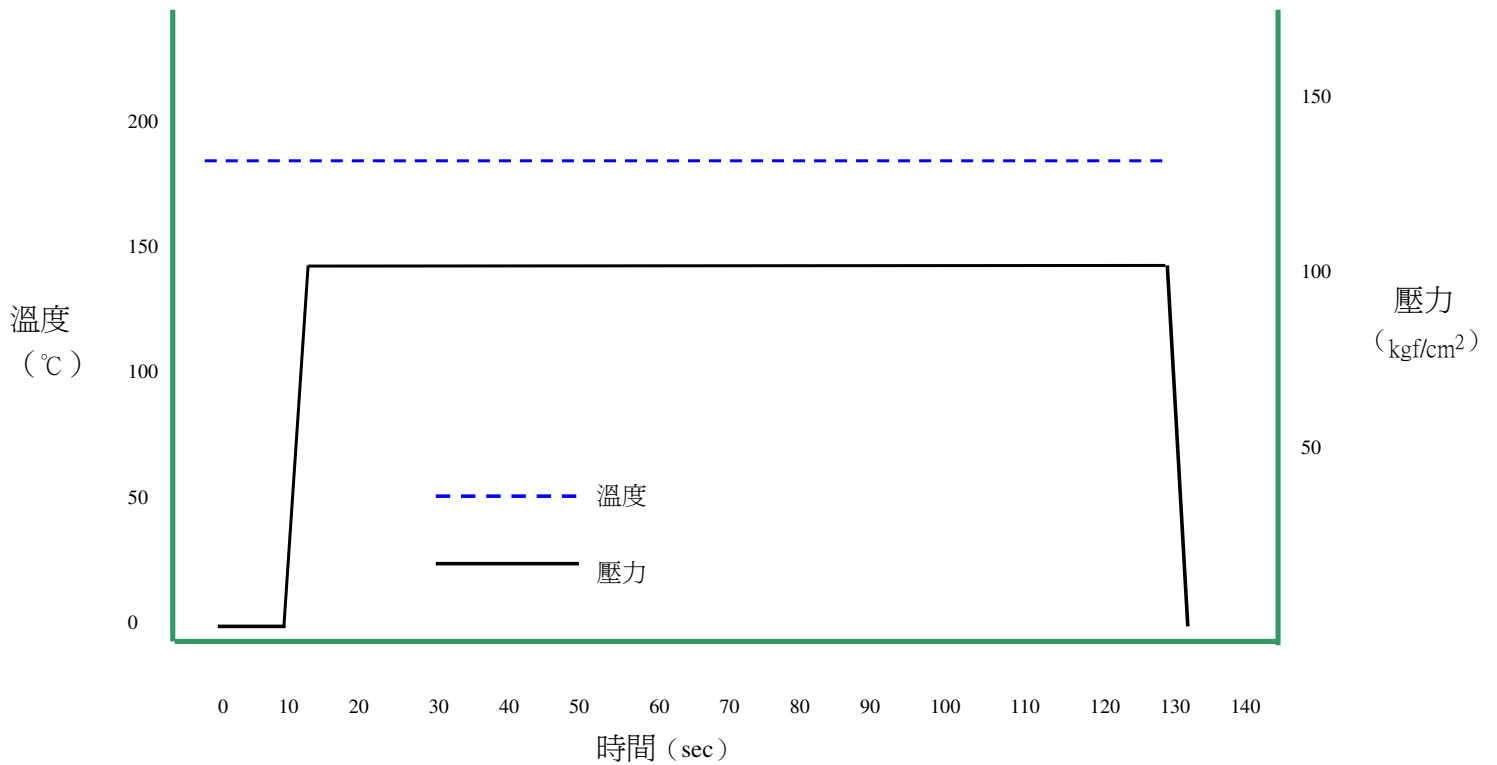
1. 壓合溫度 : 180°C(一段溫)
2. 壓合壓力 :
  - a. 預壓段 ==> 0 kg/cm<sup>2</sup>
  - b. 成型段 ==> 80~100kgf/cm<sup>2</sup>
3. 壓合時間 :
  - a. 預壓段 ==> 5~10 sec
  - b. 成型段 ==> 120 sec

## FPC 傳統平板壓合建議操作條件

1. 壓合溫度 : 160°C
2. 壓合壓力 :
  - a. 初段壓 ==> 35~40kgf/cm<sup>2</sup>
  - b. 高段壓 ==> 35~40kgf/cm<sup>2</sup>
3. 壓合時間 :
  - a. 初段壓 ==> 每分鐘 2~3°C 進行升溫
  - b. 高段壓 ==> 90min

## FPC 快速壓合曲線圖

(壓合建議曲線圖)



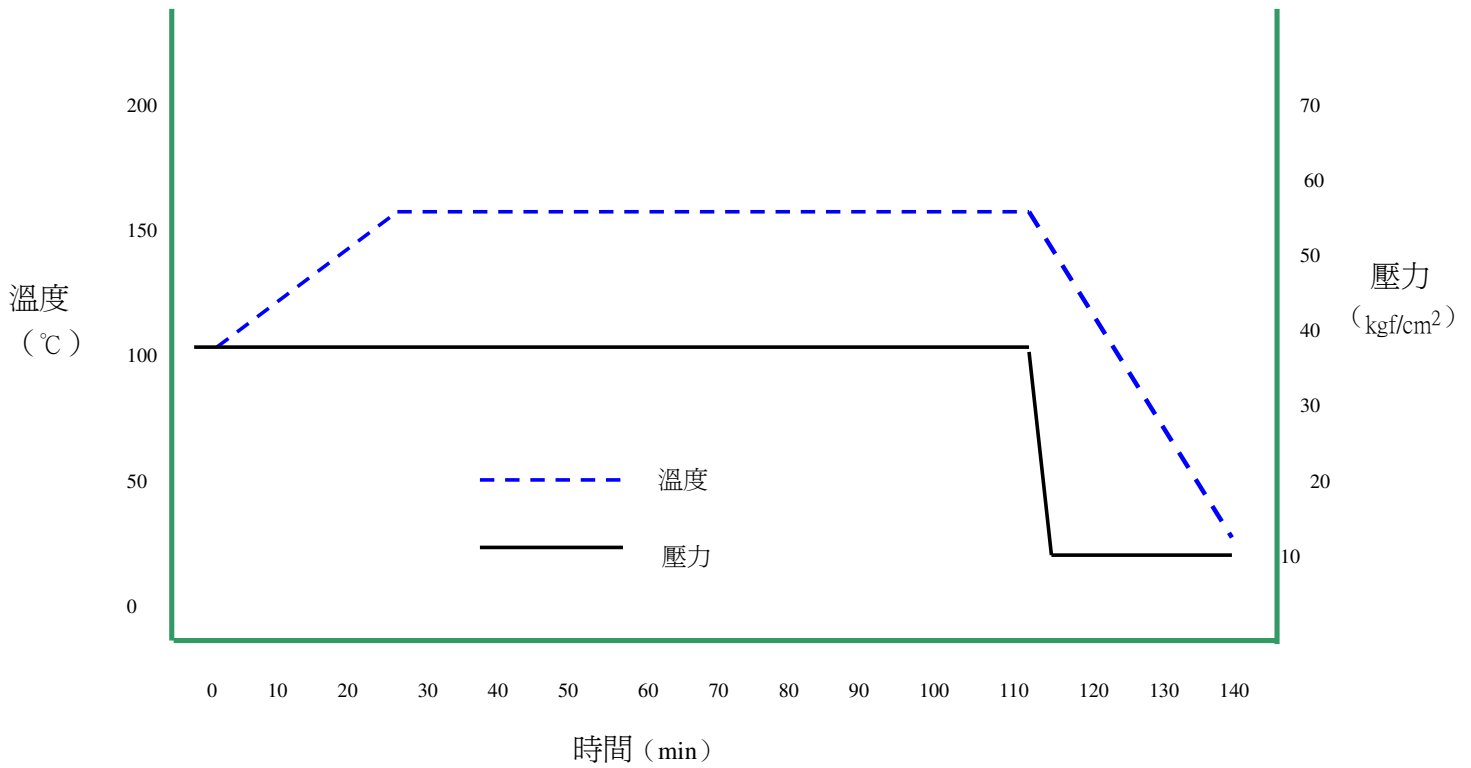
說明：

1. 於 180°C 下將待壓合成品置入，壓力為 0 kgf/cm<sup>2</sup>。
2. 進行預壓段，時間約為 5~10 秒。
3. 壓力升到 80~100 kgf/cm<sup>2</sup>，壓合約 80~120 秒。
4. 壓合後以 160°C 烘約 1~2 小時。

備註：因各司機台設備及材料皆有差異，本司所提供之壓合條件僅供貴司參考，謝謝

## FPC 傳統平板壓合曲線圖

(壓合建議曲線圖)



說明：

1. 於溫度設定為 110~130°C 時將待壓品置入，壓力設定為 30~40 kgf/cm<sup>2</sup>。
2. 以每分鐘 2~3°C 的溫度升溫，持續升溫至 160°C。
3. 當溫度升溫至 160°C 後，維持 90 分鐘壓合時間。
4. 產品壓合完畢後，將產品進行冷壓，持續降溫。

備註：因各司機台設備及材料皆有差異，本司所提供之壓合條件僅供貴司參考，謝謝

## 材料基本特性標準

### Bonding sheet BA-15

項目		標準說明	測試方式
Adhesive thickness		15 um	
Peel Strength	As received	0.8 kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.7 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.6 kgf/cm 以上	----
Solder float		288℃ x 10 sec x 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.2mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	

**Bonding sheet BA-25**

項目		標準説明	測試方式
Adhesive thickness		25 um	
Peel Strength	As received	0.8kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.7 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.6 kgf/cm 以上	----
Solder float		288℃ x 10 sec x 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.2mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	

**Bonding sheet BA-35**

項目		標準説明	測試方式
Adhesive thickness		35 um	
Peel Strength	As received	0.8 kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.7 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.6 kgf/cm 以上	----
Solder float		288℃ x 10 sec x 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.2mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	



**Bonding sheet BA-50**

項目		標準説明	測試方式
Adhesive thickness		50 um	
Peel Strength	As received	0.8 kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.7 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.6 kgf/cm 以上	----
Solder float		288℃ × 10 sec × 1 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.2mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	